

浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况

1、会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务总监李娜女士，独立董事周守利先生

二、说明会主要内容纪要

公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下：

1. 公司有数字阵列雷达技术吗？

答：公司的 ADC/DAC 芯片可以应用于数字相控阵雷达，感谢您的关注。

2. 请问公司在 5G 基带芯片是否有布局？

答：您好，公司暂未布局 5G 基带产品。

3、请问公司与华力创通的关联交易主要涉及什么产品？华力创通为华为开发的手机直连卫星芯片公司是否提供相关技术？谢谢！

答：公司与华力创通的关联交易主要涉及终端射频前端芯片、射

频收发芯片及电源管理芯片。

4、公司主要产品与国内外竞品的技术先进性比较？公司如何看待数字相控阵雷达现状以及未来的发展对现有的模拟相控阵雷达何时能升级换代？谢谢。

答：公司产品均为自主正向设计，性能与国外同类型可比产品相当，公司团队对公司业务抱有信心。

5、尊敬的郁董，您好，请问上半年影响公司收入的大环境问题是否已经逐渐改善？是否将逐步体现在明年的业绩上？谢谢。

答：您好，下半年的行业大环境是好于上半年的。

6、公司和华为是否有业务上往来和合作？

答：有合作。

7、请问郁教授，数字相控阵未来在低轨卫星领域应用前景如何？

答：您好，数字相控阵未来可应用于低轨商业卫星等领域。

8、尊敬的郁董，您好，请问高端 AD/DA 既然美国禁运，而公司产品有是国内最领先，技术上已经可以对标替代，为何国产替代进度这么慢？

答：您好，公司产品均为自主正向设计，性能与国外同类型可比产品相当，可以满足客户对于核心器件的自主可控需求。

9、尊敬的郁董，您好，公司暂无直接用于智能手机端的芯片产品，那未来有无可能有这方面的规划？

答：感谢您的建议。

10、请问郁教授，对于明年数据链市场的预期如何？是否有加速

的迹象？谢谢！

答：您好，公司团队会积极做好相关业务。

11、尊敬的李总，您好，请问公司明年的销售目标会较今年提升吗？

答：您好，公司团队积极做好公司业务，对公司发展充满信心！

12、请问郁教授，目前国内高端 AD/DA 被美国禁运，而公司产品技术是国内最领先最顶级的，年报上上讲技术上已经可以完全对标替代，这样的话市场空间极大，但是为何目前国产替代进度依然较慢呢？主要的问题是市场问题还是产品技术问题？

答：您好，公司射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC，性能与国外同类型可比产品相当，近年来国内 AD/DA 产业发展迅速，全行业公司产品均有所突破。

13、请问公司正在研发的手机直连卫星互联网芯片是用在手机端的芯片吗？是 AD/DA 还是射频芯片？谢谢！

答：您好，公司暂无直接用于智能手机端的芯片产品。

14、请问郁总，公司 3d 封装 tsv 是否属于先进封装工艺，目前是否完成流片？据了解，海外 starlink 的星载芯片用 soi 工艺，公司是否有布局该种工艺？

答：您好，公司三维异构微系统属于先进封装产品。

15、请问郁总，公司在军工数据链领域有怎样的布局？微系统和 adc 都能用吗？公司 adc 在该领域有怎样的优势？

答：您好，公司微系统及 SIP 模组和高速高精度 adc/dac 产品均

可应用于数据链领域，公司产品具有低功耗、高集成度、抗干扰等优势。

16、公司的研发方向是专攻卡脖子，高端芯片，还是也会考虑实用性和市场接受度？目前看各大芯片市场需求量都不是很大。

答：您好，公司以市场需要和客户需求为导向，坚持产品全正向研发。

17、请问郁教授，公司 AD/DA 是否可以用于脑机接口上？

答：您好，公司 AD/DA 产品无法用在脑机接口上。

18、请问郁总，公司在研的手机直连低轨卫星芯片是用在星上的还是手机端的？

答：您好，暂无直接用于智能手机端的芯片产品。

19、请问公司 14 位 4G 的 AD 是否已经是货架产品？

答：您好，公司产品已完成测试验证并正在进行优化。

20、请问郁教授公司和联盟投资的集迈科从事三维异结构封装，请问这种封装技术是不是比 chiplet 还先进的一种技术？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！我司的三维异构微系统与现有商用 Chiplets 技术采用相似的多芯片一体化集成模式，但采用不同的异构集成架构和异构集成工艺路径。我司的三维异构微系统采用多层硅转接板垂直堆叠和多层 RDL 布线工艺，实现多层多种类射频、模拟和数字芯片的三维互连集成，产品呈现为 3D 先进封装架构，主要应用于无线通信、相控阵雷达等领域。

21、请教您臻镭科技未来三年如何参与低轨卫星产业链的发展？

答：尊敬的投资者，您好！公司一直在积极布局低轨商业卫星的星载载荷、地面终端等产品。

22、请教公司的几个主要产品的技术先进性市场占有率？参与低轨商业卫星的情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品均可应用于商业低轨卫星，其中电源管理芯片、微系统及模组产品主要应用于星载载荷端。

23、请教今年四季度订单情况？明年有和展望？明年哪些产品销售增量会很好？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，公司将按照 2023 年度经营目标稳步推进工作，明年预计射频收发及高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片及微系统及模组产品销量均会有所增加，感谢您的关注！

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日